Lagebericht 2025

Der Konzern der Vishay Intertechnology, Inc. ist einer der weltweit größten Hersteller von diskreten Halbleitern (Dioden, MOSFETS und optoelektronischen Bauteilen) und von passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten). Diese Bauteile von Vishay finden Verwendung in Geräten und Produkten, die weltweit in einem sehr breiten Spektrum der Industrie gefertigt werden, z.B. in Automobilen, in der Telekommunikation, in Computern und in anderen industriellen Anwendungen. Die Vishay Semiconductor (Austria) Ges.m.b.H. unterstützt das Geschäft für das Produktsegment der Dioden.

Vöcklabruck agiert mit seiner Waferproduktion als Produzent für den Vishay Semiconductor-Geschäftsbereich. Zudem erbringt Vöcklabruck weltweit Engineering-, Entwicklungs- und andere Operationsleistungen, primär für den „Principal Manufacturer“ Vishay Semiconductor GmbH, Heilbronn.

Bericht über den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage

Geschäftsverlauf

Die Wafer-Fab in Vöcklabruck erzeugt Siliziumwafer mit diskreten Halbleiterdioden und Thyristoren zur Weiterverarbeitung in Produktionslinien in Ungarn, China und Taiwan; für Sinterglastypen, diverse Plastik-Gehäuseformen und für komplexere Modul-Bauteile. Spezielle Merkmale der Produkte sind unter anderem die hohe Energiefestigkeit im Dioden-Durchbruch und hohe mögliche Schaltgeschwindigkeiten für Anwendungen z.B. in Automobil- und Beleuchtungsindustrie.

Das Geschäftsjahr 2025 zeigte insgesamt eine nur leichte Volumen-Erhöhung gegenüber 2024 (ein Plus von ca. 8% bezogen auf die insgesamt durchgeführten Arbeistvorgänge) und blieb damit insgesamt niedriger als erwartet. Dies galt nicht nur für die in Vöcklabruck gefertigten Produkte, sondern auch für andere Schwesterwerke im Konzern (Borgaro, Taipei).

Dieser Rückgang war entkoppelt von den sich generell weiterhin auf Rekordniveau bewegenden Umsätzen für das Halbleitergeschäft weltweit (getrieben von Highend Integrierten Schaltkreisen für KI-Rechenzentren).

Der Unterauslastung wurde durch entsprechende Maßnahmen wie moderatem Personalabbau und 80% Zeitmodell im Fertigunsbereich, zeitweise Shutdowns und Einsparungen im Fixkosten-Bereich (Dienstreise-Einschränkungen, Hiring-Freeze, …) entgegengewirkt.

Aus jetziger Sicht wurde der tiefste Punkt in der Auftragslage und den Fertigungsvolumina für das Werk in Vöcklabruck nun im Februar 2026 durchlaufen. März und Quartal 2 zeigen einen Aufwärtstrend.

Positiv anzumerken ist dabei das weiterhin sehr hohe Qualitätsniveau der Produkte aus Vöcklabruck: seit 2010 gab es keine auf Chips aus Vöcklabruck zurückführbaren Reklamationen bei unseren Endkunden.

Der Standort steht im internationalen Wettbewerb nach wie vor unter hohem Kostendruck. Die Energiepreis-Situation hat sich in 2025 zwar stabilisiert, bleibt aber auf relativ hohem Niveau im Vergleich zu vor dem Beginn des Ukrainekrieges. Der moderatere Kollektivvertragsabschluss hat die Lohnkostensituation nicht mehr wesentlich weiter verschärft. Eine echte Verbesserung der Konkurrenzfzfähigkeit benötigt aber vergleichsweise niedrigere Abschlüsse auch noch für die nächsten Jahre.

Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung und durch verbesserte Prozess-Steuerung werden auch künftig weitergetrieben. Photovoltaikprojekte sollen den Einfluss der gestiegenen Energiekosten zumindest teilweise kompensieren (nächste Ausbaustufe nun für 2027 geplant).

Qualität ist ein integraler Bestandteil unserer DNA. Unser IMS – Integriertes Managementsystem – wird vom gesamten Managementteam kontinuierlich weiterentwickelt und vorangetrieben. Vishay Vöcklabruck baut dabei auf die Säulen Qualität (ISO 9001 seit 1993, IATF 16949 seit 1998), Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Die Nutzung unserer Wiki-Plattform für das IMS gewährleistet Transparenz und eine effiziente Kommunikation.

Im Jahr 2025 haben wir erfolgreich die Überwachung unserer Managementsysteme durch TÜV SÜD und GUTcert abgeschlossen sowie umfassende interne Audits, VDA 6.3 Prozessaudits und Lieferantenaudits durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen die Effektivität unserer Managementsysteme und unsere Position als verlässlicher Partner für die Elektronik- und Automobilindustrie. Dass wir auch 2025 ohne Kundenreklamationen abschließen konnten, ist ein Beweis für das Engagement und die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die nahe Zukunft, beginnend im Jahr 2026, bringt große Veränderungen, zum Beispiel den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Daher setzen wir zur kontinuierlichen Verbesserung auf bewährte Qualitätswerkzeuge und auf AUTOMATION zur permanenten Weiterentwicklung unserer Systeme und Produkte. Mit Blick auf 2026 liegt unser Fokus auf dem Abschluss der Einführung eines zukunftsweisenden MES-Systems (Fertigungssteuerung) sowie auf der kontinuierlichen Umsetzung der strategischen Ziele von VISHAY 3.0, einschließlich unserer zentralen Leitlinie „THINK CUSTOMER FIRST“.

Zweigniederlassungen

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

Forschung und Entwicklung

Für unsere in den letzten Jahren entwickelte Thyristor- und Dioden-Chipplattform wurden folgende Projekte im Jahresverlauf gestartet:

- „Neue Generation von MESA-Thyristoren mit erweitertem Temperaturbereich und verbessertem Triggerverhalten". Das Projekt zielt darauf ab, mit Hilfe optimierter Passivierungsschichten den Einsatztemperaturbereich von bisher maximal 125°C auf 150°C zu erweitern. Des Weiteren ist das Ziel, durch optimiertes Layout sowohl das Triggerverhalten als auch die Spannungsfestigkeit beim Ausschalten zu verbessern. Die Machbarkeitsstudie wird bis Anfang 2026 laufen, der Projektabschluss ist mit Q4 2026 geplant.
- „Neue Generation von MESA Dioden mit erweitertem Temperaturbereich und optimierten Stromdichten". Auch hier ist ein wesentliches Ziel, mittels modifizierter Passivierungsschichten den Einsatztemperaturbereich von bisher maximal 150°C auf 175°C zu erweitern. Durch die gesteigerte Effizienz erhoffen wir, mittels Verkleinerung der Bauteile Materialeinsparungen zu erzielen.

Fortführung des Projektes „bleifreies Glas". Sämtliche am Standort Vöcklabruck gefertigten Chips sind an den Rändern mit Passivierungsgläsern mit hohem Bleianteil versehen. Wir arbeiten mit einem namhaften deutschen Glas-Hersteller an der Umsetzung einer bleifreien Lösung für unser verwendetes Passivierungsglas. Die derzeit geltende EU-Ausnahmegenehmigung (ROHS 2) ist mit Ende 2027 befristet. Aktueller Stand: Prototypen erreichen sowohl hinsichtlich Ausbeute als auch elektrischer Parameter vergleichbare und teilweise sogar bessere Werte als die aktuelle Standardproduktion. Ein Investitionsplan der erforderlichen Betriebsmittel wurde ausgearbeitet und eingereicht, die Genehmigung ist jedoch noch offen. Derzeit existieren weltweit noch keine Mesa-Bauteile mit bleifreier Passivierung, hier sind wir dabei, uns ein weltweites Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Ertragslage:
Ergebnis vor Steuern (EvS) 2,2 Mio. € (Vorjahr 2,0 Mio. €)
Umsatzrentabilität (EvS/Umsatz): 7,5 % (Vorjahr 7,4 %)
Eigenkapitalrentabilität (EvS/durchschn. Eigenkapital): 7,3 % (Vorjahr 7,2 %)

Finanzlage:
Working Capital: 8,1 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €)
(kurzfristiges Umlaufvermögen abzgl. kurzfristiges Fremdkapital)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit +3.368 T€ (Vorjahr +3.950 T€)
Cashflow aus Investitionstätigkeit -1.597 T€ (Vorjahr -3.486 T€)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -14 T€ (Vorjahr -557 T€)

Vermögenslage:
Im Geschäftsjahr wurden verteilt auf alle Produktions- und Funktionsbereiche Investitionen in der Höhe von 1,6 Mio. € durchgeführt.
Die Bilanzsumme beträgt 38,4 Mio. € (Vorjahr 37,2 Mio. €). Die Eigenkapitalquote liegt bei 80,9 % (Vorjahr 78,9 %).

Risikobericht

Wesentliche Risiken und Ungewissheiten:

Das wirtschaftliche Umfeld für den Absatz von elektronischen Bauelementen ist nach wie vor geprägt durch die hier typischen zyklischen Schwankungen. Abhängig von der Auftragslage kommt es zu starken Veränderungen der Produktionsauslastung bzw. der notwendigen Personalkapazität.

Die Auftragslage 2025 und auch zu Beginnn 2026 ist unter den Erwartungen, mit leichtem Aufwärtstrend in der zweiten Hälfte des ersten Quartals 2026.
Ein aktuelles Risiko ist nach wie vor das im Augenblick sehr kurzfristige Bestellverhalten der Kunden – diesbezügliche Maßnahmen wie erhöhter Fertigwaferbestand in den Backend-Werken und Fokus auf Verbesserung der Produktionsdurchlaufzeiten sind im Laufen.

Das stark unvorhersehbare Verhalten der neuen US-Regierung, speziell im Hinblick auf die Zoll-Politik hatte bis dato direkt noch keine negativen Auswirkungen auf den Standort in Vöcklabruck.

Die Versorgung des Unternehmens mit Schlüsselmaterialien, insbesondere von Silizium-Wafern, ist durch Rahmenverträge abgesichert. Die Hauptlieferanten werden regelmäßig hinsichtlich Preis, Qualität und Termintreue überprüft.

Ein diesbezüglich neu hinzugekommener Risiko-Faktor ist der Anfang 2026 begonnene Iran Krieg und die damit verbundene faktische Schließung der Strasse von Hormus. Ein für die Halbleiterindustrie kritisches Material, dessen Verfügbarkeit dadurch eingeschränkt sein wird ist das Edelgas Helium.
Der Standort in Vöcklabruck ist aufgrund der hier verwendeten Produktionsprozesse aber nicht betroffen. Einschränkungen in der Verfügbarkeit anderer Materialen sind zur Zeit nicht bekannt.
Allerdings könnten mit dem Krieg einhergehende Strompreiserhöhungen eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellen.

Andere künftige Materialverfügbarkeits-Risiken:
Es wird erwartet, dass der Markt für kleine Waferdurchmesser (kleiner 6‘‘) in den nächsten Jahren weiter schrumpfen wird: daher wurden im Laufe von 2025 Sourcing Aktivitäten weitergeführt (mit dem Ziel zusätzliche Lieferanten zu qualifizieren).

Vorbereitungen zur Umstellung der Fertigung auf 6‘‘ Siliziumwafer werden fortgesetzt.

Finanzielle Risiken:

Da ausschließlich Konzernlieferungen und –leistungen durchgeführt werden, und zur Preisfindung die cost-plus-Methode Anwendung findet, ist ein Preisrisiko nicht gegeben. Der Zahlungsausgleich der Konzernforderungen erfolgt monatlich, wodurch kein Ausfallsrisiko besteht.
In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind 2.150 T€ (Vorjahr 32 T€) Cash-Pooling-Bestand enthalten. In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind 18 T€ (Vorjahr 32 T€) Cash-Pooling-Schuld enthalten.
Im Dezember 2021 wurde ein InterCompany-Darlehen in Höhe von 20,0 Mio. €, an die Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. vergeben. Inzwischen wurden bereits Teilrückzahlungen in Höhe von € 6 Mio. im November 2022 und € 2,5 Mio. im November 2023 geleistet. Da über die Entwicklung des Konzerns, der Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. und der Cash-Pooling Gesellschaft laufend Informationen eingeholt werden, kann zeitnah auf negative Entwicklungen reagiert werden.

Die laufende Liquidität ist durch einen positiven Cashflow gesichert. Es besteht kein wesentliches Fremdwährungsrisiko. Kurssicherungsinstrumente werden nicht eingesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine derivativen Finanzinstrumente hinsichtlich Sicherungsgeschäfte eingesetzt.

Mitarbeiter

Der Volumensrückgang und das volatile Bestellverhalten unserer Kunden in der Wafer-Produktion konnte ohne Abbaumaßnahmen bewältigt werden. Gemeinsam gelang es weiterhin, unser vorhandenes und neues Personal optimal einzusetzen. Die gute Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat erleichtert das flexible Reagieren auf sich kurzfristig ändernde Auftragseingänge. Das Qualitätsniveau unserer Produkte konnte erhalten werden. Die Fluktuation hält sich weiter auf einem erfreulich geringen Niveau.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt entspannt sich. Nachbesetzungen können zeitnäher durchgeführt werden. Wir möchten uns außerdem an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden für Ihren Einsatz im Namen der Geschäftsführung bedanken.

Ausblick

Die Auftragslage bewegt sich nach wie vor auf relativ niedrigem Niveau.

Ähnlich wie im Vorjahr zeigt sich nun aber eine leichte Erholung bei den Auftragseingängen (book-to-bill wieder größer als 1).

Budget und Book-to-Bill deuten für die zweite Jahreshälfte 2026 zwar auf eine positivere Entwicklung hin, allerdings lässt sich ein etwaiger Einfluss des Irankrieges zur Zeit nur sehr schwer abschätzen. Steigende Energiepreise und Supply-Chain Unterbrechungen (speziell für Asiatische High-End-Fertiger wie TSMC) können auch dämpfende Auswirkungen auf die Auftragslage hier im Werk in Vöcklabruck haben.
Derartigen Schwankungen im Fertigungsvolumen kann auch künftig durch bereits bewährte Maßnahmen wie gezielte Productions-Shutdowns und Reduktion der Arbeitszeit entgegengewirkt werden. Dabei bleibt der Standort vorbereitet auf Anstiege in der Auftragslage.

Wir gehen deshalb aus heutiger Sicht davon aus, dass auf Basis der oben angeführten Maßnahmen und einer eventuellen Inanspruchnahme von Erleichterungen und Förderungen weiterhin von einem Fortbestand des Unternehmens („Going Concern Prämisse") auszugehen ist.
Aufgrund der vereinbarten cost-plus-Transferpreisregelung bestehen auch für die Zukunft positive Ertragsaussichten.

Vöcklabruck, am 27. Mai 2026

Die Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Bernd Fankhauser

Peter Greiderer